

Neue Werkstoffe und Effizienztechnologien – BMBF-Gemeinschaftsstand präsentierte zum dritten Mal deutsche F&E-Stärken im Maschinenbau

09.12.2013

www.bvv.cz/de/msv

Spitzentechnologien im Dienst von Material- und Energieeffizienz – das waren die anschaulichen Beispiele für Innovationen aus Deutschland, die der Gemeinschaftsstand des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) auf der Internationalen Maschinenbaumesse MSV 2013 in Brunn (Tschechische Republik) präsentierte.

Zum dritten Mal in Folge zeigten deutsche F&E-Einrichtungen ihre Leistungsfähigkeit im Maschinenbau und in angrenzenden Bereichen. Die vorgestellten Technologien fanden großen Zuspruch unter den Messebesuchern und den eingeladenen Brokerage-Teilnehmern. Auch Vertreter der tschechischen Politik, die an der Standeröffnung am Auftakttag teilnahmen, zeigten sich beeindruckt von den deutschen Innovationsleistungen, die mit aktuellen tschechischen F&E-Prioritäten von Rohstoff- und Energieeffizienz übereinstimmen.

Ein hochinnovativer Seilroboter war der eindeutige Blickfang auf dem erneut mit neun Unterausstellern ausgebuchten Gemeinschaftsstand. Die Universität Duisburg-Essen veranschaulichte das Potenzial der Seilrobotertechnik, die am ehesten von Kamerafahrten bei Fußballübertragungen bekannt ist, mit einem plastisch erfahrbaren Prototyp und einer filmischen Darstellung des Einsatzes in der Lagerlogistik. Der große Vorteil dieser Technologie liegt in der Material- und damit Energieeinsparung bei z.B. Warentransport in Hochregalen.

Material- und Energieeffizienz war der Schwerpunkt des Spektrums an Innovationen auf dem diesjährigen BMBF-Stand. Mit Vitrinenexponaten präsentierten die Technische Universität Ilmenau und das Leibniz-Institut für Festkörper und Werkstoffforschung beispielsweise nanobasierte und Funktionswerkstoffe. Der Energieeffizienz gewidmet war darüber hinaus auch die Pneumatik-Demonstrationsanlage der HyPneu GmbH, Dresden, die durch ein spezielles Rücklaufverfahren die Wiederverwendung der teuer produzierten Druckluft erlaubt. Möglichkeiten der Energie- und Betriebsmitteleffizienz stellte auch die TTZH Tribologie und Hochtechnologie GmbH, Garbsen, mit ihren Prüfgeräten und -methoden zur Reibungs-, Verschleiß- und Schmierungsoptimierung vor.

Mit neuen Lösungen für etwa Elektromobilität und Logistikprozesse wartete das ICM – Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e.V. im Rahmen seiner dritten Teilnahme am MSV-Gemeinschaftsstand auf. Der AGFW | Der Energieeffizienzverband e.V., Frankfurt, sowie der Fraunhofer-Institutsteil Angewandte Systemtechnik (AST), Ilmenau, beide 2013 zum zweiten Mal unter den Ausstellern, stellten energieoptimierende Lösungen für z.B. Fernwärme und Energie- sowie Wassermanagement vor. Das Spektrum der Aussteller rundete OUT (Optotransmitter-Umweltschutz-Technologie) e.V., Berlin, ab, die für den Bereich Sensor-/Sicherheitstechnik einen Personenzähler-Prototyp zum Ausprobieren präsentierten.

Einen Eindruck von der Innovationskraft der vertretenen Aussteller machten sich auch der tschechische Vizebildungsminister Hruda und der Industrieminister Cienciala, die zur Eröffnung am Auftakttag durch den deutschen Botschafter Detlef Lingemann gekommen waren. Der Messestand mit den von der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer (DTIHK) organisierten Kontaktgesprächen bildete neue Brücken zwischen dem deutschen wie tschechischen Vorzeigebereich Maschinenbau und lieferte damit weitere Überschneidungsbereiche zwischen den beiderseits wichtigen forschungspolitischen Prioritäten von Energie- und Ressourcennachhaltigkeit.

Die Aussteller 2013 im Überblick:

- ICM - Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e.V.
- TTZH Tribologie & Hochtechnologie GmbH, Garbsen
- Technische Universität Ilmenau
- Leibniz-Institut für Festkörper und Werkstofforschung (IFW) Dresden
- Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl für Mechatronik
- HyPneu GmbH Hydraulik und Pneumatik, Chemnitz
- Optotransmitter-Umweltschutz-Technologie (OUT) e.V., Berlin
- AGFW | Der Energieeffizienzverband e.V., Frankfurt
- Institutsteil Angewandte Systemtechnik (AST) des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB), Ilmenau

Maschinenbaumesse MSV 2013

Die Maschinenbaumesse MSV ist die größte Messe am wichtigsten und traditionsreichsten (seit 1928) tschechischen Messestandort. Die diesjährige (55.) MSV konnte in den letzten Jahren zwischen 70.000 und 80.000 Besucher verzeichnen. Die Ausstellerzahl lag mit 1482 Ausstellern auf einer Ausstellungsfläche von über 35.000 m² unter den Rekordwerten von 2012. Die Beteiligung ausländischer Aussteller lag mit etwa 46% wieder sehr hoch. Aus Deutschland stammte traditionsgemäß die größte Zahl ausländischer Aussteller (knapp 300), Deutschland stellte nach der Slowakei und Polen die drittmeisten Besucher aus dem Ausland. Partnerland der MSV 2013 war die Türkei. Im Jahr 2014 findet die MSV vom 29.09. bis 03.10. statt, Partnerland wird Russland sein.

Redaktion: 09.12.2013 von Ralf Hagedorn, DLR Projektträger, Europäische und internationale

Länder / Organisationen: Deutschland, Tschechische Republik

Themen: Engineering und Produktion, Umwelt u. Nachhaltigkeit

[Zurück](#)
